

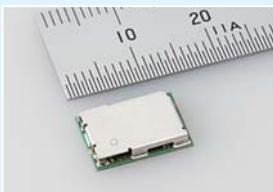
トピックス

2016

4月5日

高速無線通信規格に対応した無線モジュールを商品化

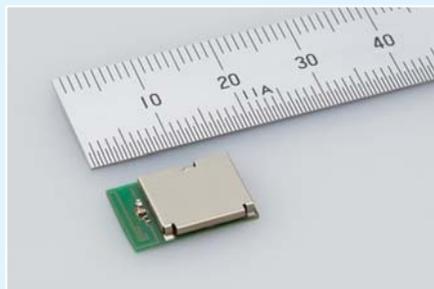
2.4GHz帯と5GHz帯を利用できるIEEE802.11ac対応の無線モジュールを商品化。工場内など無線を多用している場所でもつながりやすさと高速無線通信を実現し、M2M (Machine-to-Machine) によるロボット制御やハンディターミナルのほか、監視カメラにも最適な商品です。



9月28日

低消費電力のBluetooth®にも対応するデュアルモードモジュールを商品化

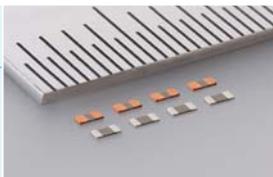
従来比約3分の1の実装面積で、Bluetooth®とBluetooth®low energyの両方に対応したデュアルモードモジュールを商品化。短距離の無線通信が必要なIoTをはじめ、ウェアラブル端末やヘルスケア向け小型・薄型機器に最適な商品です。



9月27日

低背セラミックコンデンサで業界トップの静電容量を実現

スマートフォンやウェアラブル端末向けに、大容量化技術を高度化し、外部電極を薄くすることで、積層セラミックコンデンサでは世界最薄の0.11mmで0.47 μ Fの静電容量を実現しました。

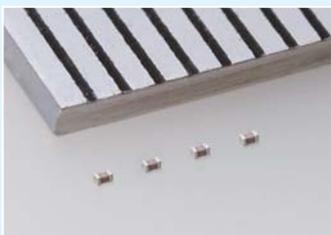


2017

2月27日

世界最小サイズの高周波積層セラミックコンデンサを実現

高周波積層セラミックコンデンサで世界最小0201サイズ(0.25×0.125×0.125mm)を商品化。従来の0402サイズから体積比で約75%小型化しつつ、世界のさまざまな通信規格や周波数帯域を使用する機器の高周波回路に対応し100アイテムをラインアップしています。



3月27日

車載向け150°Cに対応したSMDパワーインダクタを商品化

自動車のエンジン、トランスミッション等のパワートレインで使用される電源回路向けに、150°Cの高温と30Gの振動に耐えるSMDパワーインダクタを商品化。さらに品質管理強化のため、すべてに固有のデータマトリックスバーコードを印字し、生産・物流などあらゆるプロセスのトレースを1個単位で可能にしています。

